

07.02.2025 – 13:37 Uhr

ERS electronic stellt Produktions-, F&E-Standort und Kompetenzzentrum für Advanced Packaging in Deutschland vor

Barbing, Deutschland (ots/PRNewswire) -

Heute feierte [ERS electronic](#), der Branchenführer für Wärmemanagementlösungen für die Halbleiterfertigung, die offizielle Eröffnung von ERS Barbing, ihres neuen hochmodernen Produktions- und F&E-Standorts, integriert mit einem fortschrittlichen Kompetenzzentrum für Advanced Packaging und Advanced Backend-Technologien. Diese strategische Erweiterung stellt einen bedeutenden Meilenstein im Engagement von ERS dar, das europäische Halbleiter-Ökosystem zu stärken und die Zusammenarbeit in der Branche zu fördern.

Der neue Standort in Barbing bei Regensburg soll die Prozessentwicklung und Produktion der namhaften Advanced Packaging-Systeme von ERS beschleunigen. Darüber hinaus bietet das integrierte Kompetenzzentrum den Kunden einen direkten Zugang zu ERS' umfassendem technischen Know-how in den Bereichen Wafer- und Panel-Debonding sowie Warpage-Handling und -Messung. Praktische Tests, Vorführungen und Zusammenarbeit bei Prozessentwicklungen und Innovationen werden somit ermöglicht.

„Die Eröffnung dieser Niederlassung unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung von Halbleitertechnologien und die Unterstützung unserer Kunden in Europa und darüber hinaus“, sagt Laurent Gai-Miniet, CEO von ERS electronic. „Durch Vorführungen sowie professioneller und individueller Beratung möchten wir unseren Kunden dabei helfen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Fertigungsprozesse zu optimieren.“

Imre Kosa, Standortleiter von ERS Barbing, fügt hinzu: „Durch die Kombination von Produktion, Forschung und Entwicklung sowie einem Kompetenzzentrum geben wir unseren Partnern die Werkzeuge und das Wissen an die Hand, die sie benötigen, um Innovationen voranzutreiben und den wachsenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Wir laden unsere Partner und Kunden ein, bei einem Besuch zu erfahren, wie unsere Kompetenzen ihnen helfen können, Prozessherausforderungen beim Debonding und Warpage-Management zu bewältigen.“

Durch die Investition in diesen Standort stärkt ERS ihre Rolle als wichtige Akteurin in der europäischen Halbleiterindustrie. Sie schließt sich regionalen Initiativen an, die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Erhöhung der Resilienz der Lieferketten beitragen.

Um einen Besuch zu vereinbaren oder mehr über die Möglichkeiten des Kompetenzzentrums zu erfahren, können sich Interessenten an die [regionalen Vertriebsmitarbeitende](#) von ERS wenden oder eine [Besuchsanfrage](#) auf der ERS-Website senden.

Über ERS:

Die [ERS electronic GmbH](#) mit Sitz im Münchner Vorort Germering bietet seit mehr als 50 Jahren innovative Wärmemanagementlösungen für die Halbleiterindustrie an. Das Unternehmen hat sich insbesondere mit seinen schnellen und präzisen luftkühlungs-basierten thermischen Chucksystemen für das Wafer-Probing einen hervorragenden Ruf erworben. Im Jahr 2008 erweiterte ERS ihr Know-how auf dem Markt für Advanced Packaging. Heute sind ihre vollautomatischen und manuellen Debonding- und Warpage-Adjust-Systeme in den Produktionsstätten der meisten Halbleiterhersteller und OSATs weltweit zu finden.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2614530/5154818/ERS_logo.jpg

View original content: <https://www.prnewswire.com/news-releases/ers-electronic-stellt-produktions--fe--standort-und-kompetenzzentrum-fur-advanced-packaging-in-deutschland-vor-302371247.html>

Pressekontakt:

Sophia Oldeide,
Leiterin Marketing und Kommunikation,
+49 89894132143

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100089895/100928628> abgerufen werden.